



平成 19年 3月期 第3四半期業績の概況 (連結)

平成 19年 1月 22日

上 場 会 社 名 株式会社 図 研

(コード番号: 6947 東証第1部)

(URL <http://www.zuken.co.jp>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 金子 真人

問 合 せ 先 責 任 者 役職名 財 務 部 長 氏名 西 伸 孝

TEL (045) 942 - 1511

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

売上高の会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 無

2. 平成19年 3月期第3四半期(9ヶ月累計)業績の概況(平成 18年 4月 1日 ~ 平成 18年 12月 31日)

(1)連結売上高(又はこれに相当する事項)(単位 百万円未満切捨)

期	項目	売 上 高	
		百万円	%
平成19年3月期第3四半期		13,298	18.7
平成18年3月期第3四半期		11,203	9.1
(参考) 18年3月期		16,798	6.5

(注)売上高におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

(参考)販売及び受注の状況

売上高

(単位 百万円未満切捨)

期 別 品 目 別	平成19年3月期第3四半期 〔自 平成18年 4月 1日〕 〔至 平成18年12月31日〕		平成18年3月期第3四半期 〔自 平成17年 4月 1日〕 〔至 平成17年12月31日〕	
	金 額	構成比率	金 額	構成比率
		%		%
基板設計ソリューション	4,314	32.4	3,878	34.6
回路設計・ICソリューション	2,274	17.1	1,986	17.7
ITソリューション	2,070	15.6	1,362	12.2
クライアントサービス	4,617	34.7	3,943	35.2
そ の 他	21	0.2	31	0.3
合 計	13,298	100.0	11,203	100.0

受注高及び受注残高

(単位 百万円未満切捨)

期 別 品 目 別	平成19年3月期第3四半期 〔自 平成18年 4月 1日〕 〔至 平成18年12月31日〕		平成18年3月期第3四半期 〔自 平成17年 4月 1日〕 〔至 平成17年12月31日〕	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
基板設計ソリューション	4,530	541	3,958	574
回路設計・ICソリューション	2,618	534	2,438	637
ITソリューション	2,360	580	1,823	655
クライアントサービス	4,811	2,333	4,050	2,074
そ の 他	24	3	75	44
合 計	14,346	3,992	12,346	3,984

[売上高に関する補足説明]

当第3四半期の経済環境は、高水準な企業収益を背景に民間設備投資は堅調に推移し、雇用情勢にも改善が見られるなど、緩やかな景気回復を維持しているものと考えられます。

このような中で当社グループは、エレクトロニクス系製造業における設計・製造プロセス全体の効率化というお客さまのかかえる課題の解決に向けたソリューションビジネスを引続き積極的に推進してまいりました。

その結果、売上高、受注高とも順調に推移し、当第3四半期の連結売上高は、132億9千8百万円(前年同期比18.7%増)となりました。

(2)当該四半期において企業集団の財政状態及び経営成績に重要な影響を与えた事象

該当する事象は特に発生しておりません。

3. 平成19年 3月期の連結業績予想(平成18年 4月 1日 ~ 平成19年 3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
通 期	19,000	2,550	1,540	59 47

[業績予想に関する定性的情報等]

平成18年11月13日公表の通期の業績予想に変更はありません。

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

以 上